



2026-2032全球与中国AI芯片高导热界面材料市场调研报告

【行业】:化工及材料 【报告编码】:179203408474904

【出版时间】:2026-10-15 【订购热线】:+86 180 2246 3983

【电子邮件】:market@winmarketresearch.com

【报告价格】: ¥18900.00 中文电子版
¥18900.00 英文电子版
¥37800.00 中文+英文电子版

内容摘要

根据统计及预测，2025年全球AI芯片高导热界面材料市场销售额达到了9.80亿美元，预计2032年将达到24.33亿美元，年复合增长率（CAGR）为13.8%（2026-2032）。

用于AI芯片的高导热界面材料可填充芯片裸片（die）、封装盖板、冷板与散热器之间的微观缝隙，从而降低接触热阻，并将极高的热通量传导至冷却系统。此类产品涵盖金属箔、液态金属、凝胶、导热膏、相变材料、导热垫片及石墨复合材料等，需在导热率、界面热阻、贴合性、抗泵出稳定性、电绝缘性能及长期可靠性之间实现平衡。2025年，全球用于AI芯片的高导热界面材料产量约为2.8万吨。

随着AI加速器功率和封装热通量的急剧攀升，液冷技术的应用正从高端服务器扩展至更广泛的数据中心部署，从而推高了对TIM1（芯片与均热板/盖板间）、TIM1.5（均热板/盖板与冷板间）及冷板接口处高性能材料的需求。HBM（高带宽内存）与GPU的紧密封装，也使得局部温度梯度和翘曲控制变得愈发重要。

传统的导热硅脂和导热垫正向高填充导热凝胶、相变材料、钎基合金及液态金属等先进材料演进。材料的本体导热率并非衡量性能的唯一指标；润湿性、胶层厚度、组装压力、热循环表现以及抗泵出（pump-out）可靠性等因素，共同决定了实际的界面热阻。

供应商必须与封装厂、服务器OEM、冷板制造商及液冷系统提供商协同进行材料验证。鉴于AI芯片设计周期短且定制化需求高，那些能够提供多种材料形态、兼容自动化点胶工艺并拥有详尽可靠性数据的企业将更具竞争优势。

报告范围

本报告研究全球与中国市场AI芯片高导热界面材料的产能、产量、销量、销售额、价格及未来趋势。重点分析全球与中国市场的主要厂商产品特点、产品规格、价格、销量、销售收入及全球和中国市场主要生产商的市场份额。历史数据为2021至2025年，预测数据为2026至2032年。

主要厂商包括：

Indium
Henkel
Parker Chomerics
Laird Performance Materials
Shin-Etsu Chemical
Dow
DuPont
Resonac
Fujipoly
Honeywell
Boyd
3M
Momentive
深圳飞荣达科技
中石科技
碳元科技

广东思泉新材

按照不同产品类型，包括如下几个类别：

- 金属基界面材料
- 有机硅聚合物界面材料
- 非有机硅聚合物界面材料
- 石墨及碳基界面材料
- 相变界面材料
- 其他

按照不同按产品形态，包括如下几个类别：

- 导热膏及导热脂
- 导热垫片
- 导热凝胶
- 薄膜及箔材
- 液态金属
- 其他

按照不同按导热系数，包括如下几个类别：

- 5至10 W/m·K
- 10至20 W/m·K
- 20至50 W/m·K
- 高于50 W/m·K

按照不同应用，主要包括如下几个方面：

- AI GPU及加速器
- HBM堆叠
- 高性能CPU
- 网络交换ASIC
- 光模块
- 其他

重点关注如下几个地区

- 北美
- 欧洲
- 中国
- 日本
- 印度
- 东南亚

章节概要

- 第1章：报告统计范围、产品细分及主要的下游市场，行业背景、发展历史、现状及趋势等
- 第2章：全球总体规模（产能、产量、销量、需求量、销售收入等数据，2021-2032年）
- 第3章：全球AI芯片高导热界面材料主要地区分析，包括销量、销售收入等
- 第4章：全球范围内AI芯片高导热界面材料主要厂商竞争分析，主要包括AI芯片高导热界面材料产能、销量、收入、市场份额、价格、产地及行业集中度分析
- 第5章：全球AI芯片高导热界面材料主要厂商基本情况介绍，包括公司简介、AI芯片高导热界面材料产品型号、销量、收入、价格及最新动态等
- 第6章：全球不同产品类型AI芯片高导热界面材料销量、收入、价格及份额等
- 第7章：全球不同应用AI芯片高导热界面材料销量、收入、价格及份额等
- 第8章：产业链、上下游分析、销售渠道与客户分析等
- 第9章：行业动态、增长驱动因素、发展机遇、有利因素、不利及阻碍因素、行业政策等
- 第10章：报告结论

报告目录

- 1 AI芯片高导热界面材料市场概述
 - 1.1 产品定义及统计范围
 - 1.2 按照不同产品类型，AI芯片高导热界面材料主要可以分为如下几个类别
 - 1.2.1 全球不同产品类型AI芯片高导热界面材料销售额增长趋势2021 VS 2025 VS 2032
 - 1.2.2 金属基界面材料

- 1.2.3 有机硅聚合物界面材料
- 1.2.4 非有机硅聚合物界面材料
- 1.2.5 石墨及碳基界面材料
- 1.2.6 相变界面材料
- 1.2.7 其他
- 1.3 按照不同按产品形态，AI芯片高导热界面材料主要可以分为如下几个类别
- 1.3.1 全球不同按产品形态AI芯片高导热界面材料销售额增长趋势2021 VS 2025 VS 2032
- 1.3.2 导热膏及导热脂
- 1.3.3 导热垫片
- 1.3.4 导热凝胶
- 1.3.5 薄膜及箔材
- 1.3.6 液态金属
- 1.3.7 其他
- 1.4 按照不同按导热系数，AI芯片高导热界面材料主要可以分为如下几个类别
- 1.4.1 全球不同按导热系数AI芯片高导热界面材料销售额增长趋势2021 VS 2025 VS 2032
- 1.4.2 5至10 W/m·K
- 1.4.3 10至20 W/m·K
- 1.4.4 20至50 W/m·K
- 1.4.5 高于50 W/m·K
- 1.5 从不同应用，AI芯片高导热界面材料主要包括如下几个方面
- 1.5.1 全球不同应用AI芯片高导热界面材料销售额增长趋势2021 VS 2025 VS 2032
- 1.5.2 AI GPU及加速器
- 1.5.3 HBM堆叠
- 1.5.4 高性能CPU
- 1.5.5 网络交换ASIC
- 1.5.6 光模块
- 1.5.7 其他
- 1.6 AI芯片高导热界面材料行业背景、发展历史、现状及趋势
- 1.6.1 AI芯片高导热界面材料行业目前现状分析
- 1.6.2 AI芯片高导热界面材料发展趋势
- 2 全球AI芯片高导热界面材料总体规模分析
- 2.1 全球AI芯片高导热界面材料供需现状及预测（2021-2032）
- 2.1.1 全球AI芯片高导热界面材料产能、产量、产能利用率及发展趋势（2021-2032）
- 2.1.2 全球AI芯片高导热界面材料产量、需求量及发展趋势（2021-2032）
- 2.2 全球主要地区AI芯片高导热界面材料产量及发展趋势（2021-2032）
- 2.2.1 全球主要地区AI芯片高导热界面材料产量（2021-2026）
- 2.2.2 全球主要地区AI芯片高导热界面材料产量（2027-2032）
- 2.2.3 全球主要地区AI芯片高导热界面材料产量市场份额（2021-2032）
- 2.3 中国AI芯片高导热界面材料供需现状及预测（2021-2032）
- 2.3.1 中国AI芯片高导热界面材料产能、产量、产能利用率及发展趋势（2021-2032）
- 2.3.2 中国AI芯片高导热界面材料产量、市场需求量及发展趋势（2021-2032）
- 2.4 全球AI芯片高导热界面材料销量及销售额
- 2.4.1 全球市场AI芯片高导热界面材料销售额（2021-2032）
- 2.4.2 全球市场AI芯片高导热界面材料销量（2021-2032）
- 2.4.3 全球市场AI芯片高导热界面材料价格趋势（2021-2032）
- 3 全球AI芯片高导热界面材料主要地区分析
- 3.1 全球主要地区AI芯片高导热界面材料市场规模分析：2021 VS 2025 VS 2032
- 3.1.1 全球主要地区AI芯片高导热界面材料销售收入及市场份额（2021-2026）
- 3.1.2 全球主要地区AI芯片高导热界面材料销售收入预测（2027-2032）
- 3.2 全球主要地区AI芯片高导热界面材料销量分析：2021 VS 2025 VS 2032
- 3.2.1 全球主要地区AI芯片高导热界面材料销量及市场份额（2021-2026）
- 3.2.2 全球主要地区AI芯片高导热界面材料销量及市场份额预测（2027-2032）
- 3.3 北美市场AI芯片高导热界面材料销量、收入及增长率（2021-2032）
- 3.4 欧洲市场AI芯片高导热界面材料销量、收入及增长率（2021-2032）
- 3.5 中国市场AI芯片高导热界面材料销量、收入及增长率（2021-2032）
- 3.6 日本市场AI芯片高导热界面材料销量、收入及增长率（2021-2032）
- 3.7 东南亚市场AI芯片高导热界面材料销量、收入及增长率（2021-2032）
- 3.8 印度市场AI芯片高导热界面材料销量、收入及增长率（2021-2032）
- 4 全球与中国主要厂商市场份额分析
- 4.1 全球市场主要厂商AI芯片高导热界面材料产能市场份额

- 4.2 全球市场主要厂商AI芯片高导热界面材料销量（2021-2026）
 - 4.2.1 全球市场主要厂商AI芯片高导热界面材料销量（2021-2026）
 - 4.2.2 全球市场主要厂商AI芯片高导热界面材料销售收入（2021-2026）
 - 4.2.3 全球市场主要厂商AI芯片高导热界面材料销售价格（2021-2026）
 - 4.2.4 2025年全球主要生产商AI芯片高导热界面材料收入排名
- 4.3 中国市场主要厂商AI芯片高导热界面材料销量（2021-2026）
 - 4.3.1 中国市场主要厂商AI芯片高导热界面材料销量（2021-2026）
 - 4.3.2 中国市场主要厂商AI芯片高导热界面材料销售收入（2021-2026）
 - 4.3.3 2025年中国主要生产商AI芯片高导热界面材料收入排名
 - 4.3.4 中国市场主要厂商AI芯片高导热界面材料销售价格（2021-2026）
- 4.4 全球主要厂商AI芯片高导热界面材料总部及产地分布
- 4.5 全球主要厂商成立时间及AI芯片高导热界面材料商业化日期
- 4.6 全球主要厂商AI芯片高导热界面材料产品类型及应用
- 4.7 AI芯片高导热界面材料行业集中度、竞争程度分析
 - 4.7.1 AI芯片高导热界面材料行业集中度分析：2025年全球Top 5生产商市场份额
 - 4.7.2 全球AI芯片高导热界面材料第一梯队、第二梯队和第三梯队生产商（品牌）及市场份额
- 4.8 新增投资及市场并购活动
- 5 全球主要生产商分析
 - 5.1 Indium
 - 5.1.1 Indium基本信息、AI芯片高导热界面材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 - 5.1.2 Indium AI芯片高导热界面材料产品规格、参数及市场应用
 - 5.1.3 Indium AI芯片高导热界面材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 - 5.1.4 Indium公司简介及主要业务
 - 5.1.5 Indium企业最新动态
 - 5.2 Henkel
 - 5.2.1 Henkel基本信息、AI芯片高导热界面材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 - 5.2.2 Henkel AI芯片高导热界面材料产品规格、参数及市场应用
 - 5.2.3 Henkel AI芯片高导热界面材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 - 5.2.4 Henkel公司简介及主要业务
 - 5.2.5 Henkel企业最新动态
 - 5.3 Parker Chomerics
 - 5.3.1 Parker Chomerics基本信息、AI芯片高导热界面材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 - 5.3.2 Parker Chomerics AI芯片高导热界面材料产品规格、参数及市场应用
 - 5.3.3 Parker Chomerics AI芯片高导热界面材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 - 5.3.4 Parker Chomerics公司简介及主要业务
 - 5.3.5 Parker Chomerics企业最新动态
 - 5.4 Laird Performance Materials
 - 5.4.1 Laird Performance Materials基本信息、AI芯片高导热界面材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 - 5.4.2 Laird Performance Materials AI芯片高导热界面材料产品规格、参数及市场应用
 - 5.4.3 Laird Performance Materials AI芯片高导热界面材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 - 5.4.4 Laird Performance Materials公司简介及主要业务
 - 5.4.5 Laird Performance Materials企业最新动态
 - 5.5 Shin-Etsu Chemical
 - 5.5.1 Shin-Etsu Chemical基本信息、AI芯片高导热界面材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 - 5.5.2 Shin-Etsu Chemical AI芯片高导热界面材料产品规格、参数及市场应用
 - 5.5.3 Shin-Etsu Chemical AI芯片高导热界面材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 - 5.5.4 Shin-Etsu Chemical公司简介及主要业务
 - 5.5.5 Shin-Etsu Chemical企业最新动态
 - 5.6 Dow
 - 5.6.1 Dow基本信息、AI芯片高导热界面材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 - 5.6.2 Dow AI芯片高导热界面材料产品规格、参数及市场应用
 - 5.6.3 Dow AI芯片高导热界面材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 - 5.6.4 Dow公司简介及主要业务
 - 5.6.5 Dow企业最新动态
 - 5.7 DuPont
 - 5.7.1 DuPont基本信息、AI芯片高导热界面材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 - 5.7.2 DuPont AI芯片高导热界面材料产品规格、参数及市场应用
 - 5.7.3 DuPont AI芯片高导热界面材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 - 5.7.4 DuPont公司简介及主要业务
 - 5.7.5 DuPont企业最新动态

5.8 Resonac

5.8.1 Resonac基本信息、AI芯片高导热界面材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

5.8.2 Resonac AI芯片高导热界面材料产品规格、参数及市场应用

5.8.3 Resonac AI芯片高导热界面材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

5.8.4 Resonac公司简介及主要业务

5.8.5 Resonac企业最新动态

5.9 Fujipoly

5.9.1 Fujipoly基本信息、AI芯片高导热界面材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

5.9.2 Fujipoly AI芯片高导热界面材料产品规格、参数及市场应用

5.9.3 Fujipoly AI芯片高导热界面材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

5.9.4 Fujipoly公司简介及主要业务

5.9.5 Fujipoly企业最新动态

5.10 Honeywell

5.10.1 Honeywell基本信息、AI芯片高导热界面材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

5.10.2 Honeywell AI芯片高导热界面材料产品规格、参数及市场应用

5.10.3 Honeywell AI芯片高导热界面材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

5.10.4 Honeywell公司简介及主要业务

5.10.5 Honeywell企业最新动态

5.11 Boyd

5.11.1 Boyd基本信息、AI芯片高导热界面材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

5.11.2 Boyd AI芯片高导热界面材料产品规格、参数及市场应用

5.11.3 Boyd AI芯片高导热界面材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

5.11.4 Boyd公司简介及主要业务

5.11.5 Boyd企业最新动态

5.12 3M

5.12.1 3M基本信息、AI芯片高导热界面材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

5.12.2 3M AI芯片高导热界面材料产品规格、参数及市场应用

5.12.3 3M AI芯片高导热界面材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

5.12.4 3M公司简介及主要业务

5.12.5 3M企业最新动态

5.13 Momentive

5.13.1 Momentive基本信息、AI芯片高导热界面材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

5.13.2 Momentive AI芯片高导热界面材料产品规格、参数及市场应用

5.13.3 Momentive AI芯片高导热界面材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

5.13.4 Momentive公司简介及主要业务

5.13.5 Momentive企业最新动态

5.14 深圳飞荣达科技

5.14.1 深圳飞荣达科技基本信息、AI芯片高导热界面材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

5.14.2 深圳飞荣达科技 AI芯片高导热界面材料产品规格、参数及市场应用

5.14.3 深圳飞荣达科技 AI芯片高导热界面材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

5.14.4 深圳飞荣达科技公司简介及主要业务

5.14.5 深圳飞荣达科技企业最新动态

5.15 中石科技

5.15.1 中石科技基本信息、AI芯片高导热界面材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

5.15.2 中石科技 AI芯片高导热界面材料产品规格、参数及市场应用

5.15.3 中石科技 AI芯片高导热界面材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

5.15.4 中石科技公司简介及主要业务

5.15.5 中石科技企业最新动态

5.16 碳元科技

5.16.1 碳元科技基本信息、AI芯片高导热界面材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

5.16.2 碳元科技 AI芯片高导热界面材料产品规格、参数及市场应用

5.16.3 碳元科技 AI芯片高导热界面材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

5.16.4 碳元科技公司简介及主要业务

5.16.5 碳元科技企业最新动态

5.17 广东思泉新材

5.17.1 广东思泉新材基本信息、AI芯片高导热界面材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

5.17.2 广东思泉新材 AI芯片高导热界面材料产品规格、参数及市场应用

5.17.3 广东思泉新材 AI芯片高导热界面材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

5.17.4 广东思泉新材公司简介及主要业务

5.17.5 广东思泉新材企业最新动态

6 不同产品类型AI芯片高导热界面材料分析

6.1 全球不同产品类型AI芯片高导热界面材料销量（2021-2032）

6.1.1 全球不同产品类型AI芯片高导热界面材料销量及市场份额（2021-2026）

6.1.2 全球不同产品类型AI芯片高导热界面材料销量预测（2027-2032）

6.2 全球不同产品类型AI芯片高导热界面材料收入（2021-2032）

6.2.1 全球不同产品类型AI芯片高导热界面材料收入及市场份额（2021-2026）

6.2.2 全球不同产品类型AI芯片高导热界面材料收入预测（2027-2032）

6.3 全球不同产品类型AI芯片高导热界面材料价格走势（2021-2032）

7 不同应用AI芯片高导热界面材料分析

7.1 全球不同应用AI芯片高导热界面材料销量（2021-2032）

7.1.1 全球不同应用AI芯片高导热界面材料销量及市场份额（2021-2026）

7.1.2 全球不同应用AI芯片高导热界面材料销量预测（2027-2032）

7.2 全球不同应用AI芯片高导热界面材料收入（2021-2032）

7.2.1 全球不同应用AI芯片高导热界面材料收入及市场份额（2021-2026）

7.2.2 全球不同应用AI芯片高导热界面材料收入预测（2027-2032）

7.3 全球不同应用AI芯片高导热界面材料价格走势（2021-2032）

8 上游原料及下游市场分析

8.1 AI芯片高导热界面材料产业链分析

8.2 AI芯片高导热界面材料工艺制造技术分析

8.3 AI芯片高导热界面材料产业上游供应分析

8.3.1 上游原料供给状况

8.3.2 原料供应商及联系方式

8.4 AI芯片高导热界面材料下游客户分析

8.5 AI芯片高导热界面材料销售渠道分析

9 行业发展机遇和风险分析

9.1 AI芯片高导热界面材料行业发展机遇及主要驱动因素

9.2 AI芯片高导热界面材料行业发展面临的风险

9.3 AI芯片高导热界面材料行业政策分析

9.4 美国对华关税对行业的影响分析

9.5 中国企业SWOT分析

10 研究成果及结论

11 附录

11.1 研究方法

11.2 数据来源

11.2.1 二手信息来源

11.2.2 一手信息来源

11.3 数据交互验证

11.4 免责声明

报告图表

表格目录

表 1： 全球不同产品类型AI芯片高导热界面材料销售额增长（CAGR）趋势2021 VS 2025 VS 2032（百万美元）

表 2： 全球不同按产品形态AI芯片高导热界面材料销售额增长（CAGR）趋势2021 VS 2025 VS 2032（百万美元）

表 3： 全球不同按导热系数AI芯片高导热界面材料销售额增长（CAGR）趋势2021 VS 2025 VS 2032（百万美元）

表 4： 全球不同应用销售额增速（CAGR）2021 VS 2025 VS 2032（百万美元）

表 5： AI芯片高导热界面材料行业目前发展现状

表 6： AI芯片高导热界面材料发展趋势

表 7： 全球主要地区AI芯片高导热界面材料产量增速（CAGR）：（2021 VS 2025 VS 2032）&（吨）

表 8： 全球主要地区AI芯片高导热界面材料产量（2021-2026）&（吨）

表 9： 全球主要地区AI芯片高导热界面材料产量（2027-2032）&（吨）

表 10： 全球主要地区AI芯片高导热界面材料产量市场份额（2021-2026）

表 11： 全球主要地区AI芯片高导热界面材料产量市场份额（2027-2032）

表 12： 全球主要地区AI芯片高导热界面材料销售收入增速：（2021 VS 2025 VS 2032）&（百万美元）

表 13： 全球主要地区AI芯片高导热界面材料销售收入（2021-2026）&（百万美元）

表 14: 全球主要地区AI芯片高导热界面材料销售收入市场份额 (2021-2026)

表 15: 全球主要地区AI芯片高导热界面材料收入 (2027-2032) & (百万美元)

表 16: 全球主要地区AI芯片高导热界面材料收入市场份额 (2027-2032)

表 17: 全球主要地区AI芯片高导热界面材料销量 (吨) : 2021 VS 2025 VS 2032

表 18: 全球主要地区AI芯片高导热界面材料销量 (2021-2026) & (吨)

表 19: 全球主要地区AI芯片高导热界面材料销量市场份额 (2021-2026)

表 20: 全球主要地区AI芯片高导热界面材料销量 (2027-2032) & (吨)

表 21: 全球主要地区AI芯片高导热界面材料销量份额 (2027-2032)

表 22: 全球市场主要厂商AI芯片高导热界面材料产能 (2025-2026) & (吨)

表 23: 全球市场主要厂商AI芯片高导热界面材料销量 (2021-2026) & (吨)

表 24: 全球市场主要厂商AI芯片高导热界面材料销量市场份额 (2021-2026)

表 25: 全球市场主要厂商AI芯片高导热界面材料销售收入 (2021-2026) & (百万美元)

表 26: 全球市场主要厂商AI芯片高导热界面材料销售收入市场份额 (2021-2026)

表 27: 全球市场主要厂商AI芯片高导热界面材料销售价格 (2021-2026) & (美元/公斤)

表 28: 2025年全球主要生产商AI芯片高导热界面材料收入排名 (百万美元)

表 29: 中国市场主要厂商AI芯片高导热界面材料销量 (2021-2026) & (吨)

表 30: 中国市场主要厂商AI芯片高导热界面材料销量市场份额 (2021-2026)

表 31: 中国市场主要厂商AI芯片高导热界面材料销售收入 (2021-2026) & (百万美元)

表 32: 中国市场主要厂商AI芯片高导热界面材料销售收入市场份额 (2021-2026)

表 33: 2025年中国主要生产商AI芯片高导热界面材料收入排名 (百万美元)

表 34: 中国市场主要厂商AI芯片高导热界面材料销售价格 (2021-2026) & (美元/公斤)

表 35: 全球主要厂商AI芯片高导热界面材料总部及产地分布

表 36: 全球主要厂商成立时间及AI芯片高导热界面材料商业化日期

表 37: 全球主要厂商AI芯片高导热界面材料产品类型及应用

表 38: 2025年全球AI芯片高导热界面材料主要厂商市场地位 (第一梯队、第二梯队和第三梯队)

表 39: 全球AI芯片高导热界面材料市场投资、并购等现状分析

表 40: Indium AI芯片高导热界面材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

表 41: Indium AI芯片高导热界面材料产品规格、参数及市场应用

表 42: Indium AI芯片高导热界面材料销量 (吨)、收入 (百万美元)、价格 (美元/公斤) 及毛利率 (2021-2026)

表 43: Indium公司简介及主要业务

表 44: Indium企业最新动态

表 45: Henkel AI芯片高导热界面材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

表 46: Henkel AI芯片高导热界面材料产品规格、参数及市场应用

表 47: Henkel AI芯片高导热界面材料销量 (吨)、收入 (百万美元)、价格 (美元/公斤) 及毛利率 (2021-2026)

表 48: Henkel公司简介及主要业务

表 49: Henkel企业最新动态

表 50: Parker Chomerics AI芯片高导热界面材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

表 51: Parker Chomerics AI芯片高导热界面材料产品规格、参数及市场应用

表 52: Parker Chomerics AI芯片高导热界面材料销量 (吨)、收入 (百万美元)、价格 (美元/公斤) 及毛利率 (2021-2026)

表 53: Parker Chomerics公司简介及主要业务

表 54: Parker Chomerics企业最新动态

表 55: Laird Performance Materials AI芯片高导热界面材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

表 56: Laird Performance Materials AI芯片高导热界面材料产品规格、参数及市场应用

表 57: Laird Performance Materials AI芯片高导热界面材料销量 (吨)、收入 (百万美元)、价格 (美元/公斤) 及毛利率 (2021-2026)

表 58: Laird Performance Materials公司简介及主要业务

表 59: Laird Performance Materials企业最新动态

表 60: Shin-Etsu Chemical AI芯片高导热界面材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

表 61: Shin-Etsu Chemical AI芯片高导热界面材料产品规格、参数及市场应用

表 62: Shin-Etsu Chemical AI芯片高导热界面材料销量 (吨)、收入 (百万美元)、价格 (美元/公斤) 及毛利率 (2021-2026)

表 63: Shin-Etsu Chemical公司简介及主要业务

表 64: Shin-Etsu Chemical企业最新动态

表 65: Dow AI芯片高导热界面材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

表 66: Dow AI芯片高导热界面材料产品规格、参数及市场应用

表 67: Dow AI芯片高导热界面材料销量 (吨)、收入 (百万美元)、价格 (美元/公斤) 及毛利率 (2021-2026)

表 68: Dow公司简介及主要业务

表 69: Dow企业最新动态

表 70: DuPont AI芯片高导热界面材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

表 71:	DuPont AI芯片高导热界面材料产品规格、参数及市场应用
表 72:	DuPont AI芯片高导热界面材料销量 (吨)、收入 (百万美元)、价格 (美元/公斤) 及毛利率 (2021-2026)
表 73:	DuPont公司简介及主要业务
表 74:	DuPont企业最新动态
表 75:	Resonac AI芯片高导热界面材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
表 76:	Resonac AI芯片高导热界面材料产品规格、参数及市场应用
表 77:	Resonac AI芯片高导热界面材料销量 (吨)、收入 (百万美元)、价格 (美元/公斤) 及毛利率 (2021-2026)
表 78:	Resonac公司简介及主要业务
表 79:	Resonac企业最新动态
表 80:	Fujipoly AI芯片高导热界面材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
表 81:	Fujipoly AI芯片高导热界面材料产品规格、参数及市场应用
表 82:	Fujipoly AI芯片高导热界面材料销量 (吨)、收入 (百万美元)、价格 (美元/公斤) 及毛利率 (2021-2026)
表 83:	Fujipoly公司简介及主要业务
表 84:	Fujipoly企业最新动态
表 85:	Honeywell AI芯片高导热界面材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
表 86:	Honeywell AI芯片高导热界面材料产品规格、参数及市场应用
表 87:	Honeywell AI芯片高导热界面材料销量 (吨)、收入 (百万美元)、价格 (美元/公斤) 及毛利率 (2021-2026)
表 88:	Honeywell公司简介及主要业务
表 89:	Honeywell企业最新动态
表 90:	Boyd AI芯片高导热界面材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
表 91:	Boyd AI芯片高导热界面材料产品规格、参数及市场应用
表 92:	Boyd AI芯片高导热界面材料销量 (吨)、收入 (百万美元)、价格 (美元/公斤) 及毛利率 (2021-2026)
表 93:	Boyd公司简介及主要业务
表 94:	Boyd企业最新动态
表 95:	3M AI芯片高导热界面材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
表 96:	3M AI芯片高导热界面材料产品规格、参数及市场应用
表 97:	3M AI芯片高导热界面材料销量 (吨)、收入 (百万美元)、价格 (美元/公斤) 及毛利率 (2021-2026)
表 98:	3M公司简介及主要业务
表 99:	3M企业最新动态
表 100:	Momentive AI芯片高导热界面材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
表 101:	Momentive AI芯片高导热界面材料产品规格、参数及市场应用
表 102:	Momentive AI芯片高导热界面材料销量 (吨)、收入 (百万美元)、价格 (美元/公斤) 及毛利率 (2021-2026)
表 103:	Momentive公司简介及主要业务
表 104:	Momentive企业最新动态
表 105:	深圳飞荣达科技 AI芯片高导热界面材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
表 106:	深圳飞荣达科技 AI芯片高导热界面材料产品规格、参数及市场应用
表 107:	深圳飞荣达科技 AI芯片高导热界面材料销量 (吨)、收入 (百万美元)、价格 (美元/公斤) 及毛利率 (2021-2026)
表 108:	深圳飞荣达科技公司简介及主要业务
表 109:	深圳飞荣达科技企业最新动态
表 110:	中石科技 AI芯片高导热界面材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
表 111:	中石科技 AI芯片高导热界面材料产品规格、参数及市场应用
表 112:	中石科技 AI芯片高导热界面材料销量 (吨)、收入 (百万美元)、价格 (美元/公斤) 及毛利率 (2021-2026)
表 113:	中石科技公司简介及主要业务
表 114:	中石科技企业最新动态
表 115:	碳元科技 AI芯片高导热界面材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
表 116:	碳元科技 AI芯片高导热界面材料产品规格、参数及市场应用
表 117:	碳元科技 AI芯片高导热界面材料销量 (吨)、收入 (百万美元)、价格 (美元/公斤) 及毛利率 (2021-2026)
表 118:	碳元科技公司简介及主要业务
表 119:	碳元科技企业最新动态
表 120:	广东思泉新材 AI芯片高导热界面材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
表 121:	广东思泉新材 AI芯片高导热界面材料产品规格、参数及市场应用
表 122:	广东思泉新材 AI芯片高导热界面材料销量 (吨)、收入 (百万美元)、价格 (美元/公斤) 及毛利率 (2021-2026)
表 123:	广东思泉新材公司简介及主要业务
表 124:	广东思泉新材企业最新动态
表 125:	全球不同产品类型AI芯片高导热界面材料销量 (2021-2026) & (吨)
表 126:	全球不同产品类型AI芯片高导热界面材料销量市场份额 (2021-2026)
表 127:	全球不同产品类型AI芯片高导热界面材料销量预测 (2027-2032) & (吨)

表 128: 全球市场不同产品类型AI芯片高导热界面材料销量市场份额预测 (2027-2032)

表 129: 全球不同产品类型AI芯片高导热界面材料收入 (2021-2026) & (百万美元)

表 130: 全球不同产品类型AI芯片高导热界面材料收入市场份额 (2021-2026)

表 131: 全球不同产品类型AI芯片高导热界面材料收入预测 (2027-2032) & (百万美元)

表 132: 全球不同产品类型AI芯片高导热界面材料收入市场份额预测 (2027-2032)

表 133: 全球不同应用AI芯片高导热界面材料销量 (2021-2026) & (吨)

表 134: 全球不同应用AI芯片高导热界面材料销量市场份额 (2021-2026)

表 135: 全球不同应用AI芯片高导热界面材料销量预测 (2027-2032) & (吨)

表 136: 全球市场不同应用AI芯片高导热界面材料销量市场份额预测 (2027-2032)

表 137: 全球不同应用AI芯片高导热界面材料收入 (2021-2026) & (百万美元)

表 138: 全球不同应用AI芯片高导热界面材料收入市场份额 (2021-2026)

表 139: 全球不同应用AI芯片高导热界面材料收入预测 (2027-2032) & (百万美元)

表 140: 全球不同应用AI芯片高导热界面材料收入市场份额预测 (2027-2032)

表 141: AI芯片高导热界面材料上游原料供应商及联系方式列表

表 142: AI芯片高导热界面材料典型客户列表

表 143: AI芯片高导热界面材料主要销售模式及销售渠道

表 144: AI芯片高导热界面材料行业发展机遇及主要驱动因素

表 145: AI芯片高导热界面材料行业发展面临的风险

表 146: AI芯片高导热界面材料行业政策分析

表 147: 研究范围

表 148: 本文分析师列表

图表目录

图 1: AI芯片高导热界面材料产品图片

图 2: 全球不同产品类型AI芯片高导热界面材料销售额2021 VS 2025 VS 2032 (百万美元)

图 3: 全球不同产品类型AI芯片高导热界面材料市场份额2025 & 2032

图 4: 金属基界面材料产品图片

图 5: 有机硅聚合物界面材料产品图片

图 6: 非有机硅聚合物界面材料产品图片

图 7: 石墨及碳基界面材料产品图片

图 8: 相变界面材料产品图片

图 9: 其他产品图片

图 10: 全球不同按产品形态AI芯片高导热界面材料销售额2021 VS 2025 VS 2032 (百万美元)

图 11: 全球不同按产品形态AI芯片高导热界面材料市场份额2025 & 2032

图 12: 导热膏及导热脂产品图片

图 13: 导热垫片产品图片

图 14: 导热凝胶产品图片

图 15: 薄膜及箔材产品图片

图 16: 液态金属产品图片

图 17: 其他产品图片

图 18: 全球不同按导热系数AI芯片高导热界面材料销售额2021 VS 2025 VS 2032 (百万美元)

图 19: 全球不同按导热系数AI芯片高导热界面材料市场份额2025 & 2032

图 20: 5至10 W/m·K产品图片

图 21: 10至20 W/m·K产品图片

图 22: 20至50 W/m·K产品图片

图 23: 高于50 W/m·K产品图片

图 24: 全球不同应用销售额2021 VS 2025 VS 2032 (百万美元)

图 25: 全球不同应用AI芯片高导热界面材料市场份额2025 & 2032

图 26: AI GPU及加速器

图 27: HBM堆叠

图 28: 高性能CPU

图 29: 网络交换ASIC

图 30: 光模块

图 31: 其他

图 32: 全球AI芯片高导热界面材料产能、产量、产能利用率及发展趋势 (2021-2032) & (吨)

图 33: 全球AI芯片高导热界面材料产量、需求量及发展趋势 (2021-2032) & (吨)

图 34: 全球主要地区AI芯片高导热界面材料产量 (2021 VS 2025 VS 2032) & (吨)

图 35: 全球主要地区AI芯片高导热界面材料产量市场份额 (2021-2032)

图 36: 中国AI芯片高导热界面材料产能、产量、产能利用率及发展趋势 (2021-2032) & (吨)

图 37: 中国AI芯片高导热界面材料产量、市场需求量及发展趋势 (2021-2032) & (吨)

图 38: 全球AI芯片高导热界面材料市场销售额及增长率: (2021-2032) & (百万美元)

图 39: 全球市场AI芯片高导热界面材料市场规模: 2021 VS 2025 VS 2032 (百万美元)

图 40: 全球市场AI芯片高导热界面材料销量及增长率 (2021-2032) & (吨)

图 41: 全球市场AI芯片高导热界面材料价格趋势 (2021-2032) & (美元/公斤)

图 42: 全球主要地区AI芯片高导热界面材料销售收入 (2021 VS 2025 VS 2032) & (百万美元)

图 43: 全球主要地区AI芯片高导热界面材料销售收入市场份额 (2021 VS 2025)

图 44: 北美市场AI芯片高导热界面材料销量及增长率 (2021-2032) & (吨)

图 45: 北美市场AI芯片高导热界面材料收入及增长率 (2021-2032) & (百万美元)

图 46: 欧洲市场AI芯片高导热界面材料销量及增长率 (2021-2032) & (吨)

图 47: 欧洲市场AI芯片高导热界面材料收入及增长率 (2021-2032) & (百万美元)

图 48: 中国市场AI芯片高导热界面材料销量及增长率 (2021-2032) & (吨)

图 49: 中国市场AI芯片高导热界面材料收入及增长率 (2021-2032) & (百万美元)

图 50: 日本市场AI芯片高导热界面材料销量及增长率 (2021-2032) & (吨)

图 51: 日本市场AI芯片高导热界面材料收入及增长率 (2021-2032) & (百万美元)

图 52: 东南亚市场AI芯片高导热界面材料销量及增长率 (2021-2032) & (吨)

图 53: 东南亚市场AI芯片高导热界面材料收入及增长率 (2021-2032) & (百万美元)

图 54: 印度市场AI芯片高导热界面材料销量及增长率 (2021-2032) & (吨)

图 55: 印度市场AI芯片高导热界面材料收入及增长率 (2021-2032) & (百万美元)

图 56: 2025年全球市场主要厂商AI芯片高导热界面材料销量市场份额

图 57: 2025年全球市场主要厂商AI芯片高导热界面材料收入市场份额

图 58: 2025年中国市场主要厂商AI芯片高导热界面材料销量市场份额

图 59: 2025年中国市场主要厂商AI芯片高导热界面材料收入市场份额

图 60: 2025年全球前五大生产商AI芯片高导热界面材料市场份额

图 61: 2025年全球AI芯片高导热界面材料第一梯队、第二梯队和第三梯队厂商及市场份额

图 62: 全球不同产品类型AI芯片高导热界面材料价格走势 (2021-2032) & (美元/公斤)

图 63: 全球不同应用AI芯片高导热界面材料价格走势 (2021-2032) & (美元/公斤)

图 64: AI芯片高导热界面材料产业链

图 65: AI芯片高导热界面材料中国企业SWOT分析

图 66: 关键采访目标

图 67: 自下而上及自上而下验证

图 68: 资料三角测定